

Kupferbad SLOTOCOUP CU 50

Das Kupferbad SLOTOCOUP CU 50 wird bei der galvanischen Verkupferung von Leiterplatten nach dem Direktmetallisieren, zur Vorverstärkung und zum Leiterbildaufbau nach dem chemischen Verkupfern eingesetzt. Das Bad besitzt eine gute Metallverteilung, rasche Belegung der Bohrhülsen und eine ausgezeichnete Deckfähigkeit.

Die Kupferüberzüge sind feinkörnig bis mäßig glänzend und duktil.

Da die Konzentrationen der organischen Zusätze mittels CVS kontrolliert werden können, ist eine optimale Steuerung des Bades möglich. Auch über längere Betriebszeiten entstehen keine störenden Abbauprodukte, so dass aufwendige Reinigungen mit Aktivkohle entfallen.

Die Angaben in der Gebrauchsanweisung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanweisung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter www.schloetter.de/downloads eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

Falls in den verwendeten Zusätzen dieses Verfahrens SVHC-Stoffe enthalten sind, so werden diese in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern im Abschnitt 15 ausgewiesen.

